NEGATIVE TYPE PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION AND DISPLAY DEVICE USING THE SAME

Publication number: JP2002278067

Publication date:

2002-09-27

Inventor: Applicant: KOBAYASHI SATOSHI CLARIANT JAPAN KK

Classification:

- international:

G03F7/00; G03F7/038; G03F7/00; G03F7/038; (IPC1-

7): G03F7/038; C08K5/00; C08L61/06; G02F1/1339;

H01L21/027; C08L61/06; C08L101/00

- european:

G03F7/00B2; G03F7/038C Application number: JP20010078065 20010319

Priority number(s): JP20010078065 20010319

Also published as:



EP1383006 (A1) WO02075455 (A1) US2003113663 (A

Report a data error he

Abstract of JP2002278067

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a negative type photosensitive resin composition excellent in heat resistance, sensitivity, resolution and pattern shape, suitable for use as an etching resist, an ion implantation resist, a structural material of an LCD(liquid crystal display) panel such as a spacer material and an electrode barrier rib material of an organic EL(electroluminescence) display or the like and having a wide process margin. SOLUTION: In the photosensitive resin composition containing an alkali- soluble novolak resin, a crosslinker and a photo-acid generator, the alkali-soluble novolak resin has been subjected to fractionation treatment, the weight average molecular weight of the resin (expressed in term of polystyrene) is 1,000-10,000 and the proportion of a component whose molecular weight is <=500 is <=5% of the whole.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-278067 / (P2002-278067A)

最終頁に続く

(43)公開日 平成14年9月27日(2002.9.27)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FI	テーマコード(参考)
G03F 7/038	601	G 0 3 F 7/038 6	01 2H025
C08K 5/00		C08K 5/00	2H089
C08L 61/06		C 0 8 L 61/06	4 J 0 0 2
G02F 1/133	9 500	G 0 2 F 1/1339 5	0 0
H01L 21/027		(C 0 8 L 61/06	
	審査請求	未請求 請求項の数2 OL (全	7 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顏2001-78065(P2001-78065)	(71)出願人 397040605 クラリアント ジャ	パン 株式会社
(22)出顧日	平成13年3月19日(2001.3.19)	東京都文京区本駒辺	と二丁目28番8号 文京 エンターオフィス9階
		(72)発明者 小林 聡	
		静岡県小笠郡大東町	J千浜3810 クラリアン
		ト ジャパン 株式	C 会社内
		(74)代理人 100108350	
		弁理士 鐘尾 宏彩	E (外1名)

(54)【発明の名称】 ネガ型感光性樹脂組成物及びこれを用いた表示デバイス

(57)【要約】

【目的】本発明は耐熱性、感度、解像性、パターン形状が優れ、エッチングレジストやイオン注入レジスト、スペーサーなどのLCDパネル構造材料および有機ELディスプレーなどの電極隔壁材料に好適に用いるととのできるプロセスマージンの広いネガ型感光性樹脂組成物を提供する。

【構成】アルカリ可溶性ノボラック樹脂、架橋剤および 光酸発生剤を含有してなる感光性樹脂組成物において、 アルカリ可溶性ノボラック樹脂として、分別処理され、 ポリスチレン換算重量平均分子量が1,000~10, 000で、かつ分子量500以下の比率が全体の5%以 下とされたものを用いる。

1

(特許請求の範囲)

[請求項1]アルカリ可溶性ノボラック樹脂、架橋剤および光酸発生剤を含有してなる感光性樹脂組成物において、前記アルカリ可溶性ノボラック樹脂が、分別処理され、ポリスチレン換算重量平均分子量が1,000~10,000で、かつ分子量500以下の重量比率が全体の5%以下であることを特徴とするネガ型感光性樹脂組成物。

[請求項2]請求項1記載のネガ型感光性樹脂組成物の 硬化物を構造材として含む表示デバイス。

[発明の詳細な説明]

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なネガ型感光性樹脂組成物に関し、さらに詳細には、高感度、高解像力でかつ高耐熱性で、露光後ベーク(PEB)、現像などのプロセスマージンが広く、LCD(液晶ディスプレー)パネルの液晶表示面の製造や液晶表示デバイスの構造材、更には有機ELディスプレーなどの電極隔壁材料として好適に用いられるネガ型感光性樹脂組成物に関する。また本発明はこのネガ型感光性樹脂組成物の硬化物を構造材として含む表示デバイスに関する。

[0002]

【従来の技術】LCDパネルの液晶表示面の製造におい ては、従来より、ポジ型、ネガ型の各種感光性樹脂組成 物(フォトレジスト)が表示電極、配線、薄膜半導体、 カラーフィルターなどを形成する際のエッチング、イオ ン注入あるいはメッキレジスト材料などとして用いられ ている。またこれら感光性樹脂組成物をバターン状に光 硬化させた硬化物は液晶表示デバイスの構造材としても 利用されている。とれらの感光性樹脂組成物の使用は、 液晶表示装置に限らず、例えばELディスプレーなどの 表示デバイスにおいても、同様の目的での使用がなされ ている。近年LCDバネル作成用のマザーガラスは大型 化が進められているが、これと同時に表示面の高精細化 も同時に求められるようになってきている。一方、液晶 表示装置においては、装置の小型化、高密度化、駆動速 度の高速化、ディスプレーの多機能化、低コスト化に対 応すべく、液晶画面と周辺回路とを同じ基板に形成する 一体化技術(システム オン パネル)が要求されてお り、これらの要求に対応するため、半導体材料としてア モルファスシリコンに替えて低温ポリシリコンを用いた TFT液晶パネルが注目されている。そして、この低温 ポリシリコンを用いたLCDパネルにおいても、大型の LCDパネルの製造が要求されていることは前述のとお りである。

【0003】しかし、低温ポリシリコンを大型のLCDパネルにおいて採用することに伴い、イオン注入時におけるレジストへの負荷、言い換えれば基板の温度上昇が大きくなると言われている。一般的にイオン注入時にレジストの表面にかかる温度は300℃以上と言われ、従 50

来のフォトレジストではこの温度に対する耐性がないため、イオン注入温度を下げて条件を緩和せざるを得なくなる。イオン条件をより強くするためには、フォトレジスト自体の耐熱性が従来よりも優れ、かつ加熱を行ってもパターンの変形がほとんど無いものが求められている。このようにフォトレジストの耐熱性を向上させることにより、イオン条件を強くすることができ、より高性能なTFT素子を実現することが可能となるうえ、高性能なTFT素子を実現することが可能となるうえ、高エネルギーでのイオン注入が可能となることからタクトタイムが短縮できる。したがって、耐熱性に優れ、高感度、高解像度、良好なパターン形状を有するフォトレジストがますます必要になると考えられる。

【0004】しかしながら、従来汎用的に使用されてい るフォトレジストである環化ポリイソプレン系やノボラ ック系のフォトレジスト材料は、150°C程度の耐熱性 が限界であり、この限界温度を越えるとパターンだれや パターンの線幅変化がおとり、高温での耐熱性が要求さ れるプロセスには適用できないものであった。このよう な点から、耐熱性と考えられる環状オレフィン系樹脂に 感光性を付与する試みがなされてきており、例えば、ノ ルボルネン誘導体の開環重合による重合体に芳香族系ビ スアジド化合物を配合したネガ型フォトレジスト(特開 昭60-111240号公報)、ノルボルネン誘導体の 開環重合による重合体に光重合開始剤、増感剤、共重合 モノマーを配合したネガ型フォトレジスト(特開昭61 -23618号公報)等が提案されている。また、ノボ ラック系熱硬化性樹脂(特開平5-178951号公 報)、環状オレフィン系樹脂と芳香族系ピスアジド化合 物を含有する組成物(特開平7-92668号公報)な 30 どのネガ型のフォトレジストも提案されているが、いず れも耐熱性は向上しているものの充分ではなく、さらな る改善が望まれている。

【0005】一方、ノボラック樹脂の低分子量成分の比 率を減少させる手法としては、分別処理法が代表的な方 法である。これまで分別処理されたノボラック樹脂を用 いたネガ型レジストとして、特定の重量平均分子量、分 散度を有するノボラック樹脂にビスアジド化合物を添加 することにより、耐ドライエッチング性、解像度の優れ たネガ型レジストを得る技術(特開昭57-86831 40 号公報)、アルカリ可溶性樹脂が低分散度の水素添加フ ェノール樹脂であることを特徴とするレジスト(特開平 8-44061号公報)などが報告されているが、特に プロセス依存性の点で十分ではなく、改善が望まれてい る。また、特開2000-292919号公報には、ア ルカリ可溶性樹脂として薄膜蒸留法により処理されたノ ボラック樹脂を用いたボジ型の感光性樹脂組成物が報告 されているが、ネガ型のフォトレジストについての開示 はない。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上記のように、従来の

ネガ型フォトレジストでは耐熱性の不足から200℃以上の熱をパターニングされたフォトレジストに与えるとパターンだれが生じたり、パターンの線幅変化が起こっていた。このような状況に鑑み、本発明は、このような問題がない、すなわち高耐熱性であり、しかも高感度、高解像力で良好なパターンを形成することができ、寸法精度のプロセス依存性の小さいネガ型感光性樹脂組成物を提供することを目的とするものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、アルカリ 可溶性ノボラック樹脂、架橋剤、酸発生剤を含有するネガ型感光性樹脂組成物おいて、ノボラック樹脂として特定の分子量分布を有するものを用いることにより、従来のネガ型感光性樹脂組成物に比べ高感度、広プロセスマージンで、特に優れた耐熱性を有するネガ型感光性樹脂組成物が得られることを見出して本発明を成したものである。

【0008】すなわち、本発明は、アルカリ可溶性ノボラック樹脂、架橋剤および光酸発生剤を含有してなる感光性樹脂組成物において、前記アルカリ可溶性ノボラッ・20ク樹脂が、分別処理され、ポリスチレン換算重量均分子量が1,000~10,000で、かつ分子量500以下の重量比率が全体の5%以下であることを特徴とするネガ型感光性樹脂組成物に関する。

【0009】また、本発明は、上記ネガ型感光性樹脂組成物の硬化物を構造材として含む表示デバイスに関する。

【0010】以下、本発明を更に詳細に説明する。本発 ルキル 明のネガ型感光性樹脂組成物において用いられるアルカ 樹脂な リ可溶性ノボラック樹脂は、種々のフェノール類の単独 30 れる。あるいはそれらの複数種の混合物をホルマリンなどのア 【00ルデヒド類で重縮合することによって得られる。 ラミン

【0011】ことで用いるフェノール類としてはフェノ ール、p-クレゾール、m-クレゾール、o-クレゾー ル、2、3-ジメチルフェノール、2、4-ジメチルフ ェノール、2,5-ジメチルフェノール、2,6-ジメ チルフェノール、3,4-ジメチルフェノール、3,5 ージメチルフェノール、2、3、4ートリメチルフェノ ール、2, 3, 5-トリメチルフェノール、3, 4, 5 -トリメチルフェノール、2,4,5-トリメチルフェ ノール、メチレンビスフェノール、メチレンビスp-ク レゾール、レゾルシン、カテコール、2-メチルレゾル シン、4-メチルレゾルシン、o-クロロフェノール、 m-DDDDDzJ-N, p-DDDDzzJ-N, 2, 3-ジクロロフェノール、m-メトキシフェノール、p-メトキシフェノール、p-ブトキシフェノール、o-エ チルフェノール、m-エチルフェノール、p-エチルフ ェノール、2,3ージエチルフェノール、2,5ージエ チルフェノール、p-イソプロピルフェノール、α-ナ 単独でまたは2種以上の混合物として用いられる。

【0012】また、アルデヒド類としては、フォルマリンの他、パラフォルムアルデヒド、アセトアルデヒド、ベンズアルデヒド、ヒドロキシベンズアルデヒド、クロロアセトアルデヒドなどが挙げられ、これらは単独でまたは2種以上混合して使用することができる。

【0013】本発明のネガ型感光性樹脂組成物において 用いられるアルカリ可溶性ノボラック樹脂のポリスチレン換算重量平均分子量は、1,000~10,000、 10 好ましくは2,000~6,000で、かつ分子量50 0以下が全体の5%以下の比率、好ましくは3%以下の 比率である。

【0014】上記分子量を有するアルカリ可溶性ノボラック樹脂は、従来方法で合成されたアルカリ可溶性ノボラック樹脂を分別処理することにより得ることができる。アルカリ可溶性ノボラック樹脂の分別処理方法としては、従来公知のいかなる方法によってもよいが、代表的な方法としては、異なる溶解性を有する2種の溶剤中でノボラック樹脂を分別する液ー液分別法、低分子量成分を遠心分離により除去する方法、薄膜蒸留法による分別処理などを挙げることができる。この中では薄膜蒸留法が好ましい方法である。

【0015】本発明のネガ型感光性樹脂組成物で用いられる架橋剤としては、メラミン系、ベンゾグアナミン系、尿素系およびイソシアネート系化合物、あるいは多官能性エポキシド基含有化合物などの低分子架橋剤、アルコキシアルキル化メラミン樹脂あるいはアルコキシアルキル化尿素樹脂のようなアルコキシアルキル化アミノ樹脂などの高分子架橋剤が好ましい架橋剤として挙げられる。

【0016】前記メラミン系化合物としては、例えばメラミン、メトキシメチル化メラミン、エトキシメチル化メラミン、プロポキシメチル化メラミン、プトキシメチル化メラミン、ヘキサメチロールメラミンなどが、ベンゾグアナミン系化合物としては、例えばベンゾグアナミン系化合物としては、例えばベンゾグアナミン、メチル化ベンゾグアナミンなどが、尿素系化合物としては、例えば尿素、モノメチロール尿素、ジメチロール尿素、アルコキシメチレン尿素、エチレン尿素、エチレン尿素カルボン酸、テレン尿素、エチレン尿素、エチレン尿素カルボン酸、テレンテネート系化合物としては、例えばヘキサメチレンジイソシアネート、1、4ーシクロヘキシルジイソシアネート、トルエンジイソシアネート、ピスイソシアネート、トルエンジイソシアネート、ピスイソシアネートメチルシクロヘキサン、ピスイソシアネートメチルベンゼン、エチレンジイソシアネートなどが挙げられる。

チルフェノール、m-xチルフェノール、p-xチルフ 【0017】また、多官能性エポキシド基含有化合物とェノール、2、3-ジェチルフェノール、<math>2、5-ジェ しては、1分子中にベンゼン環または複素環を1個以上チルフェノール、<math>p-4ソプロビルフェノール、 $\alpha-r$ 含み、かつエポキシ基を2個以上含んでいるものが好まフトール、 $\beta-r$ フトールなどが挙げられる。これらは 50 しく、例えばビスフェノールアセトンジグリシジルエー

テル、フェノールノボラックエポキシ樹脂、クレゾール ノボラックエポキシ樹脂、トリグリシジルイソシアヌレ ート、テトラグリシジル-m-キシレンジアミン、テト ラグリシジルー1、3-ビス(アミノエチル)シクロへ キサン、テトラフェニルグリシジルエーテルエタン、ト リフェニルグリシジルエーテルエタン、ビスフェノール ヘキサフルオロアセトジグリシジルエーテル、4,4' ービス(2,3-エポキシプロポキシ)-オクタフルオ ロビフェニル、トリグリシジルーpーアミノフェノー ることができる。

【0018】更にアルコキシアルキル化メラミン樹脂あ るいはアルコキシアルキル化尿素樹脂としては、メトキ シメチル化メラミン樹脂、エトキシメチル化メラミン樹 脂、プロポキシメチル化メラミン樹脂、ブトキシメチル 化メラミン樹脂、メトキシメチル化尿素樹脂、エトキシ メチル化尿素樹脂、プロポキシメチル化尿素樹脂、ブト キシメチル化尿素樹脂などが挙げられる。

【0019】とれらの架橋剤は、単独でまたは2種以上 混合して使用することができ、その配合量は、アルカリ 20 可溶性樹脂100重量部当たり、通常2~50重量部、 好ましくは、5~30重量部である。

【0020】本発明のネガ型感光性樹脂組成物で用いら れる光酸発生剤は光の照射により酸を発生する化合物で あればどのようなものでも用いることができる。このよ うな光酸発生剤としては、従来、例えば化学増幅型レジ ストにおいて光酸発生剤として用いられているものが挙 げられる。このような光酸発生剤としては、オニウム塩 では、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、ジアゾニウム 塩、アンモニウム塩、ピリジニウム塩等が、ハロゲン含 有化合物では、ハロアルキル基含有炭化水素化合物、ハ ロアルキル基含有複素環式化合物等(ハロメチルトリア ジン誘導体等)が、ジアゾケトン化合物では、1,3-ジケトー2ージアゾ化合物、ジアゾベンゾキノン化合 物、ジアゾナフトキノン化合物等が、スルホン化合物で は、β-ケトスルホン、β-スルホニルスルホン等が、 スルホン酸化合物では、アルキルスルホン酸エステル、 ハロアルキルスルホン酸エステル、アリールスルホン酸 エステル、イミノスルホナート等が挙げられる。

【0021】とれらの光酸発生剤は、単独でまたは2種 以上混合して使用することができ、その配合量は、アル カリ可溶性樹脂100重量部当たり、通常0.1~10 重量部、好ましくは、0.5~5.0重量部である。

【0022】また、本発明のネガ型感光性樹脂組成物に は添加剤として塩基性化合物を配合することができる。 この塩基性化合物は、露光により酸発生剤から生じた酸 のレジスト膜中における拡散現象を制御し、解像度を向 上させたり、露光裕度等を向上させることができるた め、添加することが好ましいものである。このような塩 基性化合物としては、N-アルキル置換第4級アンモニ

б ウム水酸化物、第1級、第2級、第3級の脂肪族アミン 類、芳香族アミン類、複素環アミン類、アルキル基ある いはアリール基などを有する窒素化合物、アミド基ある いはイミド基含有化合物等を挙げることができる。 【0023】本発明のアルカリ可溶性ノボラック樹脂、 架橋剤および光酸発生剤などを溶解させる溶剤として

は、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレン グリコールモノエチルエーテル等のエチレングリコール モノアルキルエーテル類;エチレングリコールモノメチ ル、テトラグリシジルメタキシレンジアミンなどを挙げ 10 ルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチル エーテルアセテート等のエチレングリコールモノアルキ ルエーテルアセテート類:プロピレングリコールモノメ チルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテ ル等のプロピレングリコールモノアルキルエーテル類; プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート (PGMEA)、プロピレングリコールモノエチルエー テルアセテート等のプロピレングリコールモノアルキル エーテルアセテート類;乳酸メチル、乳酸エチル等の乳 酸エステル類;トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素 類;メチルエチルケトン、2-ヘプタノン、シクロヘキ サノン等のケトン類;N,N-ジメチルアセトアミド、 N-メチルピロリドン等のアミド類; γ-ブチロラクト ン等のラクトン類等をあげることができる。これらの溶 剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用される。 【0024】本発明のネガ型感光性樹脂組成物には、必

要に応じ染料、接着助剤および界面活性剤等を配合する ことができる。染料の例としては、メチルバイオレッ ト、クリスタルバイオレット、マラカイトグリーン等 が、接着助剤の例としては、ヘキサメチルジシラザン、 クロロメチルシラン等が、界面活性剤の例としては、非 イオン系界面活性剤、例えばポリグリコール類とその誘 導体、すなわちポリプロピレングリコールまたはポリオ キシエチレンラウリルエーテル、フッ素含有界面活性 剤、例えばフロラード(商品名、住友3M社製)、メガ ファック(商品名、大日本インキ化学工業社製)、スル フロン (商品名、旭ガラス社製)、または有機シロキサ ン界面活性剤、例えばKP341(商品名、信越化学工 業社製)が挙げられる。

【0025】また本発明のネガ型感光性樹脂組成物は、 40 スペーサーなどLCDパネルの構造材料や有機ELディ スプレーなどの電極隔壁材料に好適に用いることができ る。従来スペーサーとしては、シリカやプラスチックの 粒子が用いられている。しかしながらドットの中にスペ ーサーが入ることは画質の低下などの点から好ましくな く、粒子をばらまくのではなくパネル内のドットのない 部分に柱を立てるようにスペースを作る方法(ポストス ペーサー)もあり、そのポストスペーサーとして本発明 のネガ型感光性樹脂組成物を好適に用いることができ る。さらに、有機ELディスプレーでは3色独立発光方 50 式のRGB有機EL媒体の塗分けや電極形成が行われる

が、このときの陰極陽壁材料としても、耐熱性を有する 本発明のネガ型感光性樹脂組成物を有効に用いることが できる。

[0026]

(実施例)以下に本発明をその実施例をもって具体的に 説明するが、本発明の態様はこれらの実施例に限定され るべきものではない。

【0027】合成例1

- キシレノール16g、37重量%ホルマリン水溶液9 0g、および蓚酸1gを攪拌機、コンデンサーおよび温 度計を付した1リットルのセパラブルフラスコに仕込 み、攪拌しながら100℃で5時間反応させた。この 後、180℃まで昇温しながら1時間かけて、水、未反 応モノマーを留去し、さらに200℃まで昇温しながら 10mmHgまで減圧し、水、未反応モノマー、ホルム アルデヒドおよび蓚酸をできる限り除去した後、室温付 近に戻してノボラック樹脂を回収した。得られたノボラ米 *ック樹脂AをGPC(ゲル・パーミエイション・クロマ トグラフィー) 法により測定したときのポリスチレン換 算重量平均分子量(Mw)は7,200であった。ま た、分子量500以下の比率は全体の10.3%であっ tc.

【0028】合成例2

反応モノマーをmークレゾール70g、p-クレゾール 60gとすることを除き合成例1と同様に処理してノボ ラック樹脂を得た。こうして合成されたノボラック樹脂 400gをPGMEA600gに溶解し、この溶解溶液 に純水を入れ15分間攪拌し、室温付近で30分間静置 した後、PGMEA樹脂溶液層を取り出し、薄膜蒸留装 置(日立製作所社製)に流し込んだ後、PGMEA樹脂 溶液を連続して滴下しながら、15mmHgの減圧下、 260℃で薄膜蒸留を行い、ノボラック樹脂Bを回収し た。樹脂BのMwは4,800であった。また、分子量 500以下の比率は全体の2.11%であった。

[0029]

実施例1

(1) 合成例2で得られたアルカリ可溶性ノボラック樹脂B

100重量部

(2) ヘキサメトキシメチル化メラミン樹脂

10重量部

(3) 2 (4'-メトキシナフチル)-4, 6-トリス (トリクロロメチル)ト

リアジン

1. 5 重量部

および

(4) 水酸化テトラブチルアンモニウム

0.5重量部

をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

(PGMEA) に溶解した後、テフロン(登録商標)製 の0.2 μmメンブランフィルターでろ過し、ネガ型感 光性樹脂組成物を調製した。

【0030】との組成物を4インチシリコンウェハー上 30 に回転塗布し、100℃、90秒間ホットプレートにて ベーク後、1.5μm厚のレジスト膜を得た。このレジ スト膜にGCA社製g線ステッパー(DSW6400, NA=0、42)にて露光を行った後、120℃で90 秒間PEB (ポスト エクスポジャー ベーク) を行 い、2.38wt%水酸化テトラメチルアンモニウム水 溶液で60秒間現像してレジストパターンを形成した。 得られたレジストパターンを走査型電子顕微鏡(SE M) により観察し、3 μmパターンの最適露光量(E o)を求めた。結果を表1に示す。

【0031】比較例1

アルカリ可溶性ノボラック樹脂Bに替えて、合成例1で 得られたアルカリ可溶性ノボラック樹脂Aとすることを 除き実施例1と同様にして、ネガ型感光性樹脂組成物の 調製およびレジストパターンの形成を行った。その後、 実施例1と同様にして、3 μmパターンの最適露光量 (Eo) を求めた。結果を表1 に示す。

[0032]

【表1】

表1 感度

	实施例 1	比較例 1	
	(樹脂B)	(樹脂A)	
Εo	1 5 0	200	
(mJ/cm²)	. 100	200	

【0033】表1から、本発明のネガ型感光性樹脂組成 物の方が25%高感度であることがわかる。

【0034】実施例2

PEB温度を120℃および140℃とすることを除き 実施例1と同様に行って、レジストパターンを形成し た。各温度で形成されたパターンの線幅をSEMにより 観察し、(PEB温度140℃の線幅-PEB120℃ 40 の線幅)の値から感光性樹脂組成物のPEB温度依存性 を求めた。結果を表2に示す。

【0035】比較例2

ネガ型感光性樹脂組成物として比較例1で使用したネガ 型感光性樹脂組成物を用いることを除き実施例2と同様 に行い、感光性樹脂組成物のPEB温度依存性を求め た。結果を表2に示す。

 $\{003.6\}$

【表2】

表2 PEB温度依存性

	実施例2 (樹脂B)	比較例 2 (樹脂A)
Δ (PEB温度140℃の稼幅-PEB120℃の線幅) (μm)	0.8	1. 8

【0037】表2に示されるように、本発明のネガ型感 光性樹脂組成物のPEB温度依存による線幅のバラツキ は、従来のネガ型感光性樹脂組成物の半分以下であっ プロセスマージンが広いことが分かる。

[0038] 実施例3

PEB温度を130℃とすることを除き実施例1と同様 に行って、レジストバターンの形成を行なった。形成さ れたパターンを100、130、140、200、30 0°Cの各々の温度で3分間加熱処理を行い、SEMにて 3μmのラインパターンの形状およびボトム線幅を観察* * した。結果を表3に示す。

【0039】比較例3

ネガ型感光性樹脂組成物として比較例1で使用したネガ た。このことから、本発明のネガ型感光性樹脂組成物は 10 型感光性樹脂組成物を用いることを除き実施例3と同様 に行って、レジストパターンを形成した後、形成された パターンを100、130、140、200、300℃ の各々の温度で3分間加熱処理を行い、SEMにて3 μ mのラインパターンの形状およびボトム線幅を観察し た。結果を表3に示す。

[0040]

【表3】

表3 加熱処理後のパターン形状および線幅

加熱温度	100℃	130℃	140℃	200℃	300℃
実施例3	3. 0 µm	3. 0 µm	3. 0 µm	3. 2 µm	3. 3 µ m
	3. 0 µm	3. 9 µm	4. 2μm	パターンと	
比較例3		パターンが	パターン垂れ	パターンが	
		丸みをおびる	が目立つ	つながった	

[0041]表3に記載されるように、本発明のネガ型 感光性樹脂組成物については、300℃でもラインパタ ーンの形状に大きな変化はなかった。一方、従来のネガ 型感光性樹脂組成物は、130℃付近からラインバター ンの形状が変化し始め、200℃では形成したラインパ をおこなうととはできなかった。

[0042]

[発明の効果]以上詳しく述べたように、本発明によ ※

※り、耐熱性に優れ、かつ高感度、高解像性で、良好なパ ターンを形成することができ、しかも寸法精度のプロセ ス依存性の小さいネガ型感光性樹脂組成物を得ることが できる。また、本発明のネガ型感光性樹脂組成物は、表 示素子製造時のエッチングレジスト、イオン注入用レジ ターンとラインパターンがつながってしまい、線幅観察 30 ストあるいはメッキレジストなどとして有用であるのみ ならず、スペーサーなどのLCDパネル構造材料および 有機ELディスプレーなどの電極隔壁材料に好適に用い ることができる。

フロントページの続き

(S1) Int.Cl.'

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

//(C08L 61/06 101:00)

C08L 101:00) HO1L 21/30

502R

F ターム (参考) 2H025 AA01 AA02 AA03 AA04 AA10 AB17 AC01 AD01 BE00 CB29 CB52 CB55 CC20 FA03 FA17 2H089 LA06 MA04X MA05X QA12 4J002 CC031 CC222 CC232 CD002 CD032 CD052 CD062 CD132 CD142 EN137 EQ017 ER006 ET016 EU186 EV207 EV247 EV297 FD142 FD146 FD207 GP03 CQ00

THIS PAGE BLANK (USPTO)